

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TYSiC

Guangdong Tianyu Semiconductor Co., Ltd.

廣東天域半導體股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2658)

盈利警告

本公告乃由廣東天域半導體股份有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此知會本公司股東(「**股東**」)及潛在投資者，根據董事會對本集團截至2026年6月30日止六個月(「**2026年上半年**」)的最新未經審核綜合管理賬目及董事會目前可得資料作出的初步評估，本集團預期於2026年上半年錄得淨虧損介乎約人民幣104百萬元至人民幣123百萬元，而截至2025年6月30日止六個月(「**2025年上半年**」)則錄得淨溢利約人民幣30.9百萬元。

董事會認為，預期由淨溢利轉為淨虧損主要歸因於以下因素的累積影響：

- (i) 儘管收入溫和同比增長，惟毛利大幅下降。於2026年上半年，碳化硅（「**碳化硅**」）外延片市場的供需再平衡及持續激烈的價格競爭導致2026年上半年碳化硅外延片的平均售價較2025年上半年同比下降。此情況進一步受到2026年第一季度的慣常季節性放緩及農曆新年假期的影響，導致產量下降及固定製造成本的吸收減弱。儘管客戶訂單及產量於2026年第二季度逐步恢復，但該恢復並未完全抵銷2026年上半年產生的固定製造成本及折舊。本集團的毛業績亦受到存貨撇減的非現金撥備的不利影響，主要歸因於估計售價下降及於2026年6月30日的存貨結餘較於2025年12月31日有所增加。存貨增加主要由於為履行手頭上較多的客戶訂單而增加生產，導致須計提撥備的存貨基數擴大。本集團的毛業績進一步受撇銷或動用過往存貨撇減所產生的收益較2025年上半年大幅減少所影響；
- (ii) 其他淨收入減少，主要由於港元兌人民幣貶值導致本集團以港元計值的資金產生匯兌虧損淨額增加；及
- (iii) 行政及其他經營開支增加，主要由於2025年上半年的金融資產減值虧損撥回，轉為2026年上半年的貿易應收款項減值虧損，此乃因本集團根據若干貿易應收款項結算進度較預期緩慢的情況，重新評估其預期信貸虧損所致。

於本公告日期，本公司仍在落實本集團於2026年上半年的綜合業績。本公告所載資料僅為董事會根據本集團於2026年上半年的未經審核綜合管理賬目及本公司目前可得的其他資料作出的初步評估，並非基於任何經董事會審計委員會審閱或確認，或經本公司核數師審閱或審核的數據或資料。本集團於2026年上半年的實際業績可能與本公告所披露者有所不同。有關本集團實際財務業績及表現的進一步詳情及有關2026年上半年預期淨虧損的進一步資料，將於有關本集團2026年上半年中期業績的公告內披露，預期該公告將根據上市規則刊發。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
廣東天域半導體股份有限公司
主席兼執行董事
李錫光

香港，2026年8月14日

截至本公告日期，董事會包括執行董事李錫光先生，非執行董事歐陽忠先生及姜達才先生，獨立非執行董事賀正生先生、李旻女士及錢榮澤先生。